



Tagesordnung

- Thema: **34. Treffen des Arbeitskreises**
„Richtlinienkonformes Design für WEEE, RoHS und ErP“
- Datum: **Dienstag, den 10. März 2015, 10:00 Uhr**
- Ort: Forschungsschwerpunkt Technologien der Mikroperipherik, TUB,
Gustav-Meyer-Allee 25, Gebäude 17a, Treppe 5, 2. Etage, Raum 294,
13355 Berlin
- Teilnehmer: Arbeitskreismitglieder, Referenten

Tagesordnungspunkte:

10:00 Uhr

Begrüßung und Aktuelles aus der Gesetzgebung

Nils Nissen, Fraunhofer IZM

10:30 Uhr

**Entwurf der Leitlinien zur Umsetzung der Verordnung 801/2013 für
Netzwerk-Standby**

Lutz Stobbe, Fraunhofer IZM

10:50 Uhr

**Aktuelle Entwicklungen im Produktumwelt- und Produktsicherheitsrecht –
Ein Überblick jenseits von ErP, RoHS, REACH und WEEE**

Jens Nusser, Kopp-Assenmacher Rechtsanwälte

11:30 Uhr

**Weiterentwicklung der RoHS: Neue Stoffrestriktionen und
Erfahrungsbericht aus Sicht der Kommission**

Hans-Christian Eberl, Europäische Kommission

12:10 Uhr

Lignin in der Elektronikindustrie

Jana Rückschloss, Fraunhofer IZM

12:40 Uhr

Mittagspause



13:40 Uhr

Umsetzung des WEEE Recast in Europa: Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Meike Ruoff, WEEEllogic

14:20 Uhr

Konfliktmineralienfreie Halbleiter: Wie kann die Zulieferkette kontrolliert werden?

Thomas Osburg, Intel Germany

15:00 Uhr

Kaffeepause

15:30 Uhr

Produktdesign – Ein Hebel für eine effizientere Rückgewinnung von kritischen Metallen?

Perrine Chancerel, TU Berlin

16:00 Uhr

Abschließende Diskussion

Ende gegen 16.20 Uhr